

[글로벌 AI]

권영배, CFA

yb.kwon@miraeeasset.com

[반도체]

김영건

younggun.kim.a@miraeeasset.com

[차이나테크]

강민희

minhui.kang@miraeeasset.com

[글로벌 AI 인프라]

장다현

dahyun.jang@miraeeasset.com

[글로벌 로보틱스]

박선영

seunyoung.park@miraeeasset.com

[글로벌 테크]

김수민

sumin.kim.b@miraeeasset.com

One-Asia Tech Strategy

9월: 빅테크의 대안

- 주주환원으로 주가 안정, 환율은 단기 부담 요인에 그칠 것
- 주요 기업들이 확인해주는 견고한 AI 수요; 신규 커버리지 개시
- 한국 메모리 선호 유지, 빅테크 설비투자 우려는 아리스타로 헤지

8월 리뷰: 주주환원으로 안정된 주가

지난 8월 글로벌 테크 업종 주가는 전반적으로 안정을 찾았다. 특히 SK하이닉스와 삼성전자는 우리의 예상보다 빠른 시점에 대규모 주주환원 발표했고, 본격적인 자사주매입이 시작되며 시장에 실질적인 유동성을 불어넣고 있다. 한편, 현재까지 3분기 평균 환율(USDKRW)은 1,451원으로 2분기 평균 환율 1,500원 대비 3.3% 낮아졌다. 단기적으로 반도체/전기전자 등 수출기업의 실적 부담 요인이다. 그러나, 환율의 추가 하락 여지가 크지 않다는 점에서 장기 이익전망은 견고할 것이다.

기업들이 알려주는 견고한 AI 수요

최근 발표된 기업 실적에서 우리는 근원적인 AI 수요에 주목했다. 엔비디아의 70%에 달하는 매출 성장 가이드는 강력한 컴퓨팅수요에 대한 자신감을 보여준다. 에어비엔비, 세일즈포스 등 플랫폼/SaaS 기업들은 실적 개선의 중요한 이유로 AI를 들었다. 특히 세일즈포스는 'Claudeforce'를 소개하며, 프론티어 AI에 세일즈포스 고유 데이터와의 결합을 강조했다. 이는 SaaS 기업들의 도메인지식과 데이터가 강력한 AI와 결합하며 실질적인 경제적 가치를 창출할 수 있다는 것을 보여준다.

신규커버리지: 아리스타 네트워크, 나우라

우리는 8월에 글로벌 AI인프라, 중국 반도체, 로보틱스 업종에 대한 커버리지를 개시했다. 글로벌 AI인프라(AI도 결국 연결발 - 장다현, 2027년 8월 10일 참고) 업종 최선호주는 아리스타 네트워크(ANET US)다. 데이터센터 및 네트워크 시장의 성장으로 27년 가파른 실적 성장이 예상된다. 중국 반도체업종 최선호주는 Naura다(승천을 향한 도약 - 강민희, 8월 13일 참고). 전공정 장비 대부분을 공급하며 중국 반도체 설비투자자 수혜가 이어지고 있다. 휴머노이드 중심의 로보틱스 업종은 빠른 성장이 예상되나(휴머노이드 붉은 온다 - 박선영, 8월 21일 참고), 밸류에이션 부담으로 선호도는 낮다.

One-Asia 테크 포트폴리오

한국 메모리(삼성전자, SK하이닉스) 주식을 지속 추천하며, 장기적인 멀티플 상승을 예상한다. 이들은 주주환원 여력이 소진된 글로벌 빅테크의 대안이다. 중국 반도체는 ETF 접근을 권하되, 리스크 감내력이 높은 투자자에게는 나우라를 추천한다. 글로벌 빅테크는 클라우드 시장 점유율이 상승하고 있는 알파벳(GOOG US)을 추천한다. 아리스타 네트워크는 빅테크의 자본지출이 과도하다고 우려하는 투자자에게 좋은 대안이다.

I. AI 수혜를 넘어 이익의 질을 묻다

극심했던 7월의 조정 이후, 8월 글로벌 테크 업종은 전반적으로 안정을 찾았다. 최근 1개월 13개 그룹 중 11개 그룹의 12개월 선행 EPS 전망이 상향됐으며, 110개 종목 가운데 EPS 전망이 오른 종목은 74개로 약 67%였다. 주가가 상승한 종목도 72개로 전체의 65%를 차지했고, 그룹별로는 13개 중 11개가 상승했다.

그룹별 EPS 리비전과 주가수익률을 살펴보면, 프로세서/컴퓨터 그룹이 엔비디아의 호실적에 힘입어 EPS와 주가가 각각 11.7%, 8.3% 상승했고, 메모리/스토리지도 2.4%, 6.1%, 소재는 3.6%, 4.2% 오르며 이익과 주가가 동반 개선됐다. 반면 후공정/패키지기는 EPS 상향 폭이 2.5%에 그쳤지만 주가는 16.6% 상승했고, 서버시스템/부품도 EPS +3.2%에 주가는 10.8% 올랐다. 시장은 현재의 이익 상황뿐 아니라 가격 상승과 제품믹스 개선이 만들어낼 다음 추정치 상향을 선반영한 것으로 보인다.

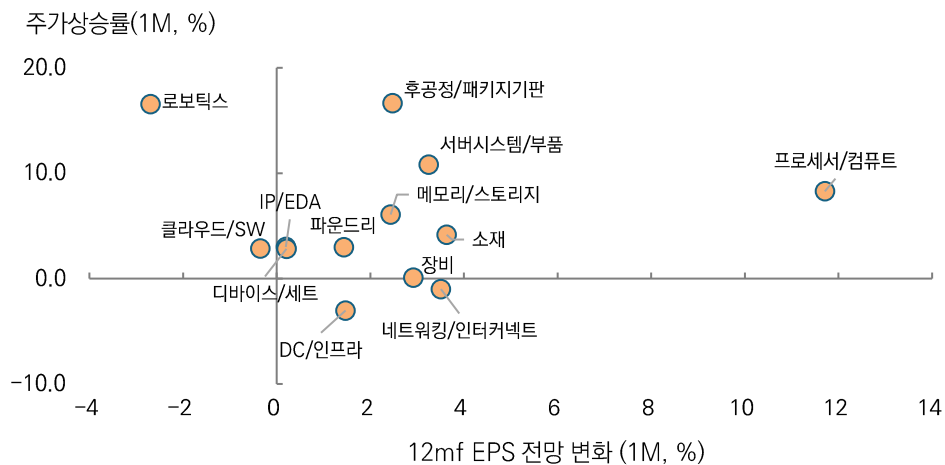
반면 네트워킹/인터넷, 장비, DC/인프라는 EPS 전망이 각각 3.5%, 2.9%, 1.5% 상향됐음에도 주가는 하락 및 보합에 그쳤다. 장기 성장성에 대한 의심이라기보다 선행했던 주가와 높은 밸류에이션을 소화하는 과정에 가까워 보인다. 특히 수주와 투자가 실제 매출로 전환되는 데 시간이 필요한 산업은 시장의 평가 기준이 2026년 투자 확대에서 2027년 실적 가시성으로 이동하고 있다. 향후에도 시장의 관심은 단순한 AI 노출 여부보다 이익의 지속성, 가격 결정력, 주주환원, 실적 도착 시점을 기준으로 종목과 업종을 선별할 것이다.

표 1. 그룹별 12개월 선행 이익전망치 변화, 밸류에이션, 주가 비교

그룹	그룹명	개수	12mf EPS Revision (%)			12mf PER		12mf PBR		Performance (%) *로컬통화기준					
			1W	1M	3M	시총 가중	중앙값	시총 가중	중앙값	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD
1	메모리/스토리지	11	1.0	2.4	26.0	5.5	6.3	2.8	3.7	2.3	6.1	(13.8)	78.1	694.7	201.2
2	프로세서/컴퓨터	9	9.9	11.7	16.8	19.7	37.1	10.1	11.9	5.5	8.3	(0.0)	44.1	65.6	42.5
3	네트워킹/인터넷	13	0.2	3.5	6.1	23.5	31.2	9.3	9.2	2.2	(1.0)	(10.4)	33.2	72.4	34.3
4	파운드리	5	0.0	1.4	13.4	21.0	20.4	6.4	3.5	1.7	3.0	(2.1)	13.1	82.3	38.8
5	IP/EDA	3	0.5	0.2	1.6	51.0	37.4	7.8	12.2	4.5	3.0	(22.2)	57.1	38.4	72.5
6	장비	13	0.1	2.9	17.3	30.6	30.8	14.2	12.7	(2.7)	0.1	2.7	22.0	155.2	65.4
7	소재	7	0.2	3.6	3.7	22.8	21.6	3.2	3.4	(0.8)	4.2	(15.2)	3.6	76.1	42.0
8	후공정/패키지판	12	0.0	2.5	22.6	26.7	23.0	4.2	5.2	2.4	16.6	(3.1)	78.0	341.4	203.5
9	서버시스템/부품	9	0.7	3.2	13.0	17.7	14.9	4.8	4.2	4.5	10.8	(1.3)	133.7	249.4	185.1
10	DC/인프라	7	(0.0)	1.5	8.7	30.2	37.0	5.3	7.1	(1.6)	(3.0)	(8.6)	1.7	57.6	36.7
11	클라우드/SW	9	(0.0)	(0.3)	8.2	20.7	19.7	4.9	5.0	0.9	2.8	(1.9)	16.3	18.8	4.9
12	디바이스/세트	4	(0.1)	0.2	(0.7)	31.9	15.6	24.2	18.2	2.1	2.8	1.9	21.5	36.6	18.2
13	로보틱스	8	(2.1)	(2.7)	(8.2)	93.5	157.5	7.7	6.0	5.0	16.6	(16.9)	(10.1)	15.0	(15.5)

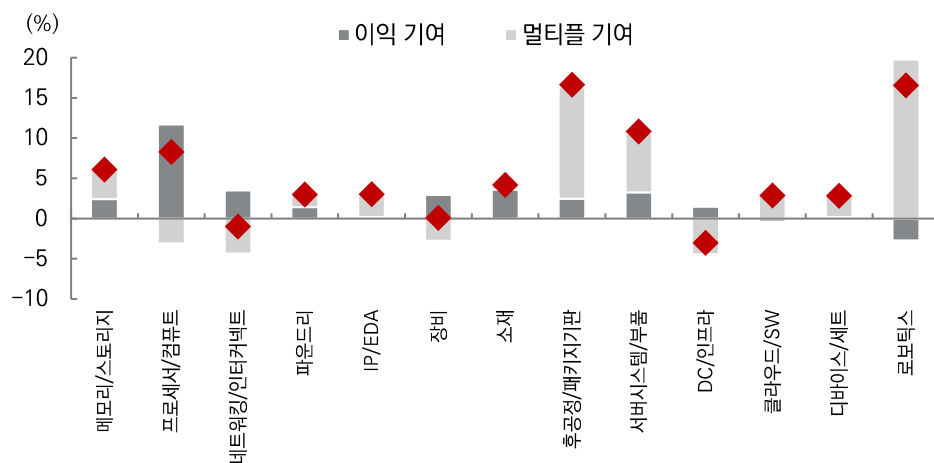
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터 | 주: 기준일자 26.08.31, 그룹별 시총가중 평균 적용

그림 1. 1개월 주가상승률 vs. 12개월 선행 EPS 전망 변화



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터 | 주: 기준일자 26.08.31, 그룹별 시총가중 평균 적용

그림 2. 주가 수익률 분해 = 이익변화 vs. 멀티플 변화



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터 | 주: 기준일자 26.08.31, 그룹별 시총가중 평균 적용

II. 메모리, 이익 지속성과 주주환원 확인의 시간

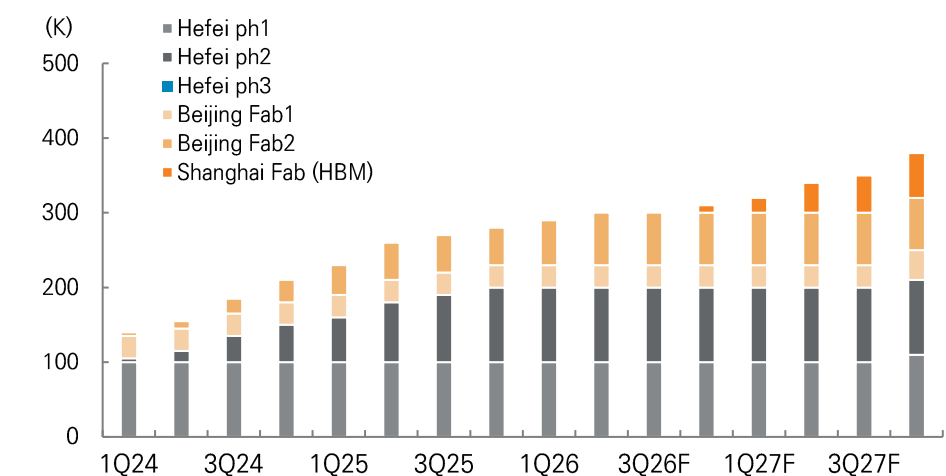
메모리·스토리지 그룹은 이익의 지속성과 주주환원이 확인되며 밸류에이션 재평가를 자극 할만한 환경의 변화가 연이어 보고되고 있다.

당사는 2028년까지 타이트한 DRAM 수급이 지속될 것으로 추정하며, HBM 가격 인상 효과를 주도로 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM ASP도 상승세를 이어갈 것으로 전망한다. 매출의 50%를 웃도는 LTA 비중은 실적의 변동성 자체도 낮출 것이다.

주주환원 또한 하방을 지지한다. 8월, 삼성전자는 2026년 90~110조원 규모의 주주환원을 제시했고, SK하이닉스도 40조원 규모의 자사주 매입·소각과 누적 FCF 50% 이상의 환원 원칙을 발표했다. 환원 기조의 상향은 향후 현금흐름 창출의 가시성을 높게 여겼다는 방증이다.

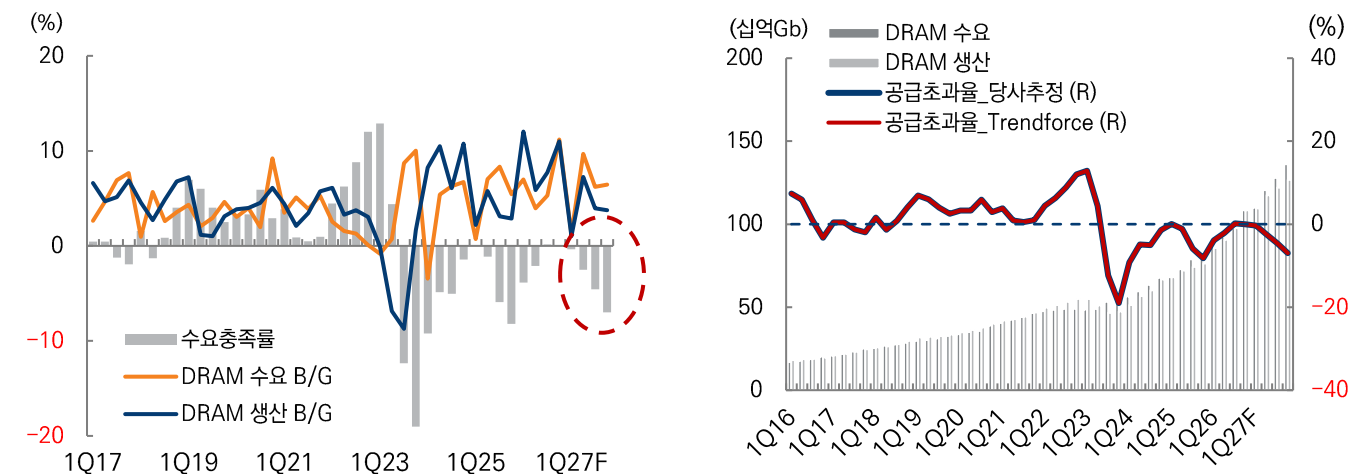
당사는 지난 8/17~22간 중국 현지 반도체 7사를 답사했다(중국 반도체, 반도체 기업 답사기 - 강민희, 김영건 2027년 8월 25일 참고). 답사에서 확인한 것은 중국 AI 수요의 주체가 정부 보조금에서 CSP와 AI 모델사의 실수요로 이동했고, 실제 CSP의 Capex 계획은 한두 달 만에 재차 상향되고 있는 점이다. 또한 중국 가속기 업체들의 HBM 수요는 빠르게 증가하는데 반해 중국의 HBM 자립도는 예상보다 낮아보였다. 현지 업체들이 예상하는 HBM3급 자급 시점은 약 2년 뒤다. 폭증하는 수요를 자급이 따라가지 못하기에 CXMT의 HBM 생산 확대는 불가피하다. 하지만 HBM의 Capa 잠식율은 4배에 가까워, CXMT가 HBM 생산을 확대할수록 일반 DRAM 생산능력은 오히려 잠식된다. **삼성전자, SK하이닉스의 관점에서 보면, 중국발 수급 교란은 제한적이며, 오히려 가격의 상방 요인이라는 판단이다.**

그림 3. CXMT 팹별 생산능력 추이 및 전망



자료: 미래에셋증권 리서치센터

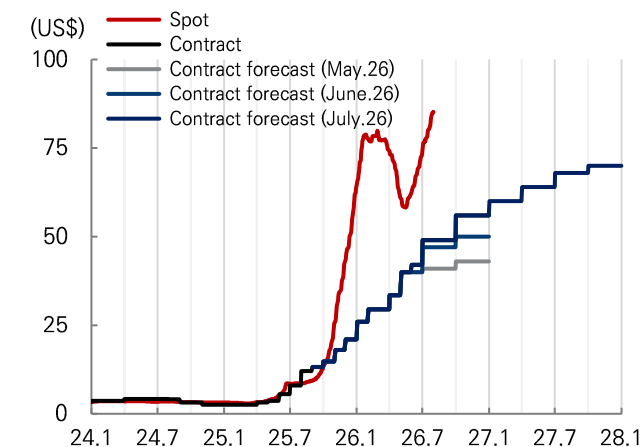
그림 4, 5. DRAM 공급과잉을 추이 및 전망



자료: 미래에셋증권 리서치센터

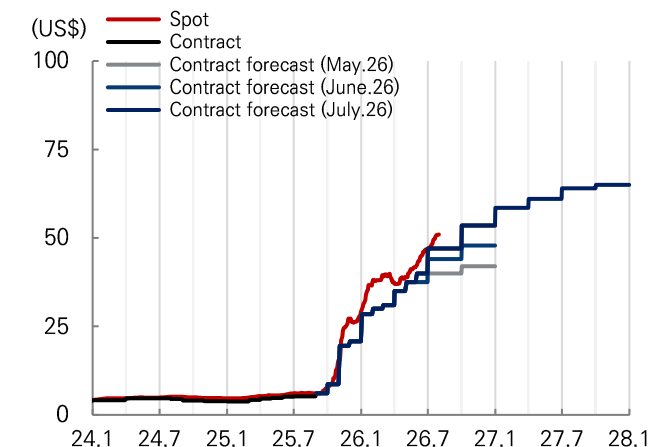
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. DRAM DDR4 현물가격 및 계약가격 전망



자료: DRAMeXchange, 미래에셋증권 리서치센터

그림 7. DRAM DDR5 현물가격 및 계약가격 전망



자료: DRAMeXchange, 미래에셋증권 리서치센터

III. 중국 반도체, 정책 기대에서 실적 사이클로

중국 반도체는 정책 기대에서 실적 사이클로 이동하고 있다. 변화의 출발점은 중국 AI 소프트웨어의 경쟁력이다. DeepSeek와 Kimi 등 로컬 모델의 성능이 높아지면서 컴퓨팅 수요가 확대됐고, 미국의 수출규제는 CSP가 엔비디아에만 의존하기 어려운 환경을 만들었다. 그 결과 중국산 AI 가속기의 현지 출하 비중은 2025년 41%까지 상승했다. 수요가 정책으로 만들어질 것이라는 기대를 넘어 실제 출하로 확인되기 시작한 것이다.

현지 답사에서는 수요의 주체도 달라지고 있음을 확인했다. 보조금에 의존한 지방정부 프로젝트보다 가동률과 경제성을 중시하는 민간 수요가 성장의 중심으로 이동하고 있다. 바이트댄스·알리바바·텐센트·바이두의 합산 Capex는 2026년 1,180억달러에서 2027년 1,540억달러로 증가할 전망이다. 엔비디아 제품의 공급 불확실성과 CSP의 국산 이원화 전략을 고려하면 중국 가속기 업체에 배분될 가능성은 높아지고 있다. 판매 단위도 GPU 단품에서 클러스터로 커지고 있다. Moore Threads는 매출 구조가 2년 전 GPU 단품 중심에서 서버·스위치·스토리지를 포함한 클러스터 솔루션 중심으로 바뀌었다고 설명했다.

국산 AI 가속기에 대한 수요의 확산은 생산설비 투자로 연결되고 있다. SMIC·Hua Hong·CXMT·YMTC의 합산 Capex는 2025년 1,572억위안에서 2026년 2,006억위안, 2027년 2,240억위안으로 증가할 전망이다. 중국산 가속기와 메모리 수요가 늘면서 파운드리·메모리 증설이 함께 진행되고, 이는 다시 국산 장비업체의 수주로 이어지는 구조다.

현지 장비업체에서는 이 수요가 실제 계약으로 전환되고 있음을 확인했다. 중국 장비 국산화율은 전체 20~30%, 식각은 약 40%로 추정된다. AMEC과 Piotech는 인증을 통과한 장비가 양산 구매로 전환되고 있으며, 계약 방식도 단건 PO에서 기존 PO 2~3건의 물량을 묶는 PA로 확대됐다고 설명했다. 수주부터 납품·설치·검수를 거쳐 매출로 인식되기까지 약 1~1.5년이 걸린다. 따라서 2026년의 발주는 2026년 말부터 2027년 실적으로 전환될 가능성이 높다.

당사의 중국 반도체 탐픽은 NAURA(TP 1,100위안)이다. 중국은 EUV를 확보하지 못해 DUV 멀티패터닝으로 선단공정을 구현해야 한다. 노드가 미세해질수록 동일한 회로를 만들기 위한 식각과 증착 공정 횟수가 증가한다. 웨이퍼 투입량이 늘지 않아도 장비 수요가 증가하는 구조다. NAURA는 식각·증착·세정·열처리 등 대부분의 전공정 장비를 공급한다. 한 공정의 국산화가 아니라, 중국 팹의 장비 국산화율 상승 전반에 노출돼 있다는 점이 차별점이다. 1Q26말 기준 820억 위안의 수주잔고가 2027년까지의 실적을 뒷받침한다.

그림 8. 중국 CSP Capex 추이 및 전망

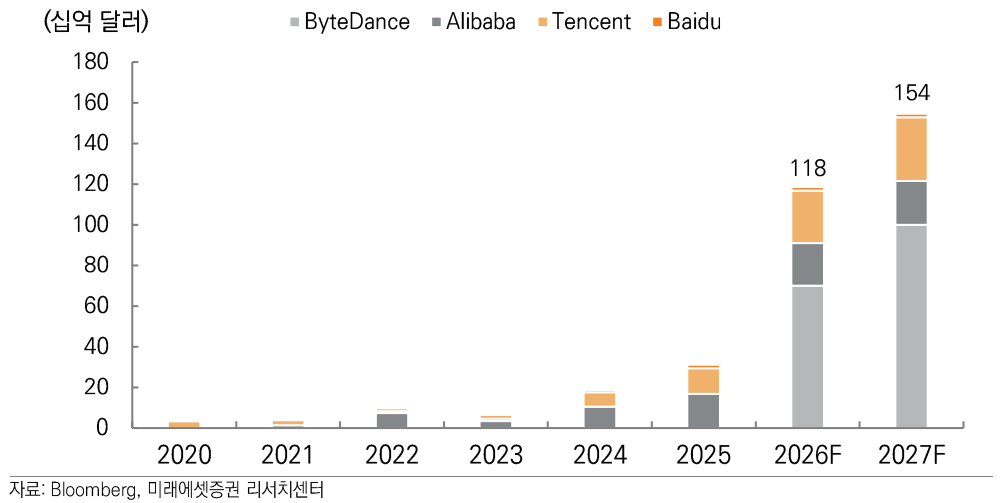
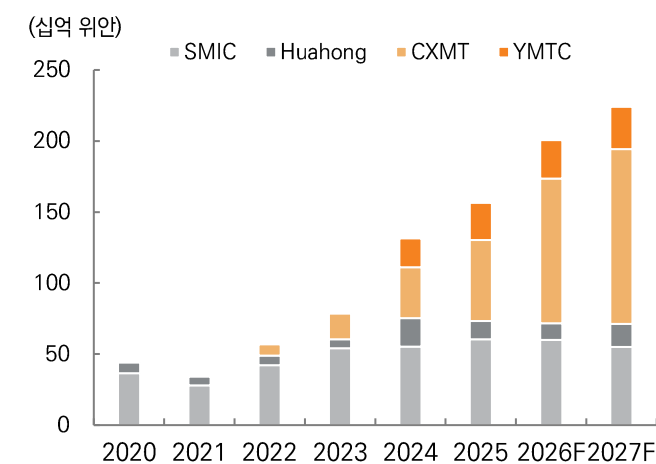


표 2. 중국 반도체 장비 공정별 국산화 현황

공정	자립도	주요 국산 업체	글로벌 선두 업체	WFE 내 비중	최근 국산화 진행 내용
노광	1% 미만	SMEE	ASML	27%	28nm 노광기(SSA800-10W, 24년 개발) SMIC 납품 추정. 실사용 수준 도달에 최소 5년 소요 전망
계측/검사	5% 안팎	Skyverse RSIC	KLA, AMAT	15%	28nm급 결함 검출 장비 고객사 인증 24년 말 통과. 3D 형상 및 박막 두께 측정 장비 현지 라인 적용 중
증착	40% 상회	NAURA	AMAT, Lam, TEL	26%	23년 400여 종 PVD 출시, 누적 출하 3,500대 초과. NAURA 24년 ALD 양산 진입
식각	40% 상회	NAURA AMEC	Lam, TEL	23%	ICP/CCP 14nm 양산, 14~7nm 검증 중. CCP 5nm, ICP 5~3nm 연구 단계. AMEC, TSMC 난징팩에 5nm급 유전체 식각기 10대 공급 예정
세정	30~40%	ACM NAURA	SCREEN Lam, TEL	식각에 합산	28nm 이하 TEBO 단일 웨이퍼 세정 자체 개발. 0.5um~28nm 대응
평탄화(CMP)	40%	Hwatsing	AMAT, Ebara	~10%	28nm 양산, 14nm 검증 단계. 5nm급에서 AMAT 및 Ebara와 격차
이온주입	10%	Wanye, BEST-E	AMAT, Axcelis	~10%	28nm 공정 전면 대응 중

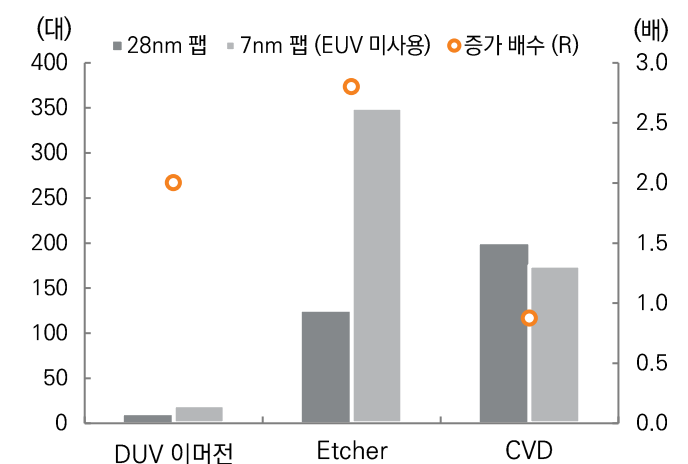
주: WFE 내 비중은 Yole Group의 4대 세그먼트 분류 기준이며, 식각과 세정은 합산 집계된다.
자료: Yole Group, 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

그림 9. 중국 파운드리 및 메모리 업체 Capex 추이 및 전망



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 10. 노드별 펌 장비 소요 대수(월 5만 장 기준)



자료: The Information Network, 미래에셋증권 리서치센터

IV. 예상보다 빠르게 성장할 네트워크 시장

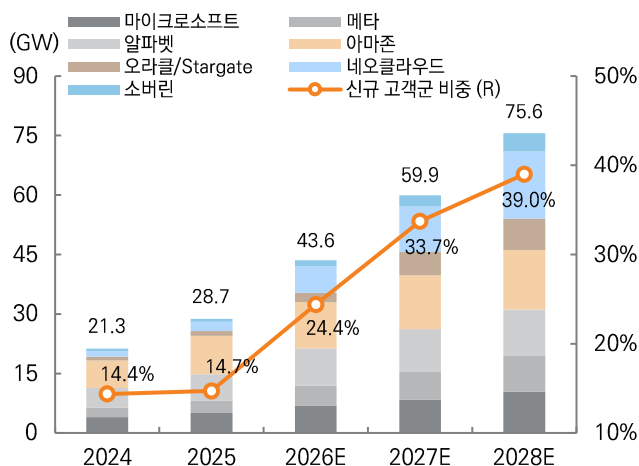
기존 데이터센터 및 네트워크 시장의 수요는 하이퍼스케일러의 Capex로 추정했다. 그러나 최근에는 금융리스, 외부 컴퓨팅 계약, 네오클라우드와 합작법인의 투자가 늘어났고 이에 따라 공시된 Capex만으로 정확한 수요를 측정하기 어려워졌다. 이에 따라 당사는 실제 가동 가능한 IT 전력으로 네트워킹 수요를 다시 계산했다(글로벌 AI 인프라, AI도 결국 연결 밭 – 장다현, 2027년 8월 10일 참고).

106개 데이터센터 캠퍼스와 121개 클라우드 리전을 IT 전력 기준으로 추적한 결과, AI 데이터센터 IT 전력은 2025년 25.3GW에서 2028년 77.6GW로 3.1배 증가한다. 순증 52.3GW의 62%는 상용 장비 의존도가 높은 오라클, 네오클라우드, 소버린에서 발생한다.

여기서 네트워크 시장의 TAM을 가속기 수량 x 가속기당 네트워크 콘텐츠 x 외부조달비중으로 분해할 때, 800G 및 1.6T로의 고속화, 연결 범위의 확대와 개방형 이더넷 확산은 해당 네트워크 탑재액과 외부 조달 비중을 함께 높인다. 이에 상용 네트워크 시장 규모는 2024년 280억 달러에서 2028년 1,874억 달러로 6.7배 성장하여 데이터센터 용량보다 더 빠르게 성장을 보일 것으로 전망한다.

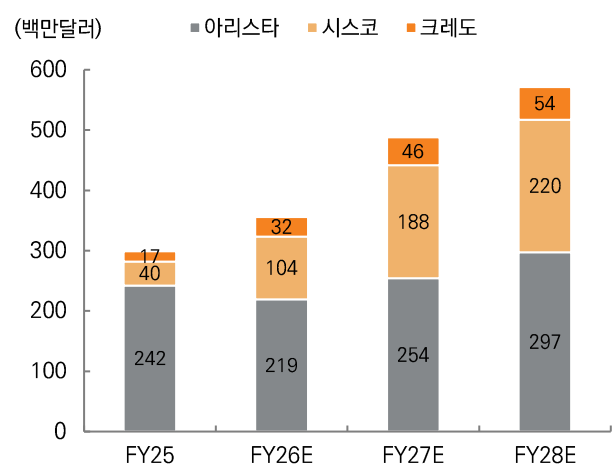
2027년 네트워크 이익 성장은 네 축이 만든다. **1) Q:** AI 가속기 출하가 2025~2028년 2.6배 늘고 증가분의 68%를 ASIC이 차지한다. 이들은 엔비디아 규격을 쓸 수 없어 개방형 이더넷을 채택한다. **2) P:** 800G와 1.6T 전환으로 가속기당 외부 네트워크 탑재액이 5,288달러에서 9,190달러로 74% 오르며, 대역폭당 가격 하락을 물량과 속도가 앞지른다. **3) Timing:** 네트워크 매출은 CapEx를 약 1년 후행해, 2026년에 확보한 수주와 선구매 부품이 2027년부터 매출로 인식된다. **4) Mix:** 광은 2028년 상용시장의 44%인 824억 달러로 가장 큰 계층이고, 포트 속도가 바뀔 때마다 교체돼 주기가 짧다. 가속기 1대당 광 연결 단가는 700달러에서 1,500달러로 오르며, 아직 구리인 랙 내부 스케일업까지 광으로 열리면 이는 당사 추정 밖의 추가 상방이다. 물량, 단가, 매출 시점, 제품 믹스가 동시에 개선되는 2027년이 이익 성장의 변곡점이다.

그림 11. 고객군별 AI 데이터센터 IT전력 및 신규 고객군 비중 추정



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 12. AI 데이터센터 1GW가 만드는 네트워크 3사 매출



자료: 미래에셋증권 리서치센터

표 3. 네트워크 시장 TAM 추정 (연간 기준)

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
1. 가속기 출하량 (Q, 백만대)					
1) 엔비디아 GPU	4.1	5.1	7.6	8.7	8.9
↳ DC Compute 매출 (십억달러)	102	162	293	416	514
↳ 세대 블렌드 단가 (달러/GPU)	24,985	31,575	38,400	48,075	57,740
2) AMD GPU	0.3	0.4	0.6	1.0	1.4
↳ 계약 GW	-		0.5	1.5	2.5
↳ GW당 칩 수 (만대/GW)	44		44		44
↳ 기존 고객 (MI300X/355X, 백만대)	0.3	0.4		0.4	0.3
3) AI ASIC (조달 가능)	2.2	3.7	6.1	10.6	13.8
↳ [참고] 시장 전체 (중국 국산, 자체 아키텍처 포함)	2.7	4.5	7.7	13.0	17.0
총 가속기 출하량	6.6	9.2	14.3	20.3	24.1
↳ 비-엔비디아 가속기	2.5	4.1	6.7	11.6	15.2
↳ 비-엔비디아 비중	38%	44%	47%	57%	63%
2. 가속기 1대당 외부 네트워크 콘텐츠 (P, 달러)					
1) 엔비디아 GPU (외부 조달계수 1.0배)	4,743	5,288	5,970	7,213	9,190
2) AMD GPU (1.0배)	4,743	5,288	5,970	7,213	9,190
3) AI ASIC (계층별 차등, 연도별)	3,363	3,737	4,287	5,231	6,719
3. 네트워크 TAM (십억달러)					
1) 외부 조달 네트워크 시장	28.0	43.0	75.2	125.1	187.4
↳ 엔비디아 GPU	19.4	27.2	45.5	62.4	81.8
↳ 비-엔비디아 가속기	8.6	15.8	29.6	62.7	105.5
↳ 외부 시장 내 비-엔비디아 비중	31%	37%	39%	50%	56%
↳ AMD GPU	1.2	2.2	3.7	7.3	12.9
↳ AI ASIC	7.4	13.6	25.9	55.4	92.7
2) 엔비디아 내재화 네트워크 시장	15.9	26.7	50.5	77.9	88.8
총 네트워크 시장	44.0	69.7	125.7	203.0	276.2

주1: 외부 조달 네트워크 시장은 가속기 플랫폼 사업자가 자체 공급하는 네트워크 가치를 제외하고, 외부 장비, 부품, 소프트웨어 업체가 공급할 수 있는 영역을 의미

주2: AI ASIC 출하량은 상용 업체가 조달 가능한 물량 기준으로, 화웨이 등 중국 국산과 Groq 등 자체 아키텍처 가속기는 제외. 시장 전체는 참고 행에 별도 표기

주3: TAM = 가속기 출하량 × 가속기당 외부 조달 네트워크 콘텐츠 × 외부 조달 계수. 계수는 각 플랫폼 네트워크 중 상용 부품 업체가 공급 가능한 비중(NVIDIA, AMD 1.0)이며, ASIC은 제품 계층별로 차등 적용(스위치 시스템은 프로그래머블 이더넷 채택률, AEC/리타이머 0.90, 광 트랜시버/DSP 0.85, NIC/기타 0.50)해 계층 비중으로 가중한 값을 연도별로 사용. 2026년 71.8% → 2028년 73.1%. AMD 1.0은 UALink 기반 스케일업 개발 구간을 반영하지 않은 보수적 가정으로, 실현 시 상방 요인.

자료: Bloomberg, DIGITIMES, 각 사, 미래에셋증권 리서치센터 추정

V. 로봇틱스, 휴머노이드의 본격적인 양산 확대

로봇틱스 그룹의 현재 EPS는 아직 주가 상승을 설명하지 못한다. 실적 개선보다는 산업의 초기 양산 진입에 대한 기대감에 가깝다. 휴머노이드 산업은 기술·원가·양산·수요의 네 측면에서 동시에 변곡점에 도달했다고 보는데, 2025년 글로벌 휴머노이드 출하량은 약 2.2만 대로 증가했고, 2026년 상반기에만 1.9만대가 출하됐다. 이 가운데 70% 이상이 산업·상업 용으로 추정된다. 연구·교육·전시 중심의 수요가 제조·물류·상업 현장으로 이동하며 초기 상용화가 시작되고 있음을 뜻한다. 앞으로 확인해야 할 것은 일회성 실증이 반복 발주로 이어지는지, 출하량이 실제 매출로 인식되는지, 생산량 확대가 원가 하락과 이익 개선으로 연결되는지다. 소량 PoC가 대량·반복 발주로 전환되는 시점을 휴머노이드 상용화의 '2차 변곡점'으로 판단한다.

중국은 이 변화에서 가장 앞서 있다. 2025년 글로벌 출하의 90% 이상을 차지했고, 2026년 상반기에는 97%를 차지했다. 특히, 유니트리는 2025년 매출 17억위안, 전년 대비 335% 성장과 흑자전환을 기록하며, **양산 확대가 원가 하락과 실적 개선으로 연결될 수 있음을 먼저 입증했다**. 유비테크도 2025년 풀사이즈 휴머노이드 1,079대를 출하했고, 경쟁사 유니트리를 따라 가파른 매출 성장 구간에 진입하고 있다. 당사 **로봇틱스** **타픽 역시 유비테크(TP 120HKD)**인데, 1) 휴머노이드 산업 성장의 수혜를 받을 수 내 선두주자라는 위상, 2) 안정적 캐시카우로 자리잡은 기존 로봇 사업, 3) 로봇틱스와 AI 역량을 모두 갖춘 풀스택 사업자로서의 경쟁력에 주목한다.

국내에서는 완제품보다 핵심 부품이 이 변화에 먼저 노출된다. 완제품은 아직 PoC와 공급망 구축 단계지만, 액추에이터와 감속기는 프로토타입 제작과 파일럿 생산 과정에서 완제품보다 먼저 수요가 발생한다. 휴머노이드에는 25~50개의 액추에이터가 필요하고 관련 부품이 원가의 절반 이상을 차지한다. 여러 OEM에 공급할 수 있는 액추에이터·감속기 기업은 완제품의 최종 승자와 무관하게 개발 경쟁과 양산 확대의 수혜를 받을 수 있다. 차선호주로 주목하는 로보티즈(TP 356,000원)은 휴머노이드 핵심 부품인 액추에이터에 대한 높은 노출도를 바탕으로 본격적인 양산 단계 진입 시 매출 레버리지가 크게 나타날 것으로 본다.

그림 11. 25년 글로벌 휴머노이드 기업 출하량 약 2.2만대

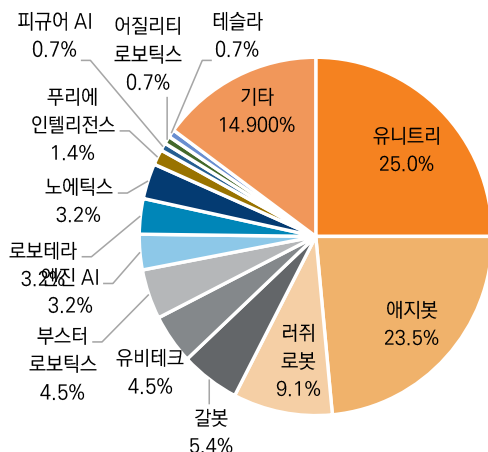


그림 12. 25년 중국 휴머노이드 기업 출하량 약 2만대

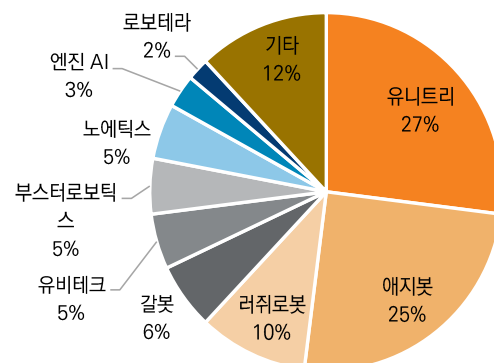
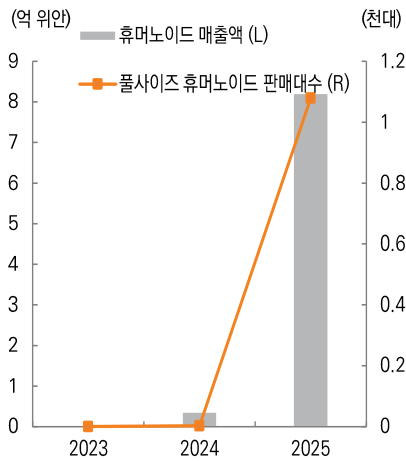
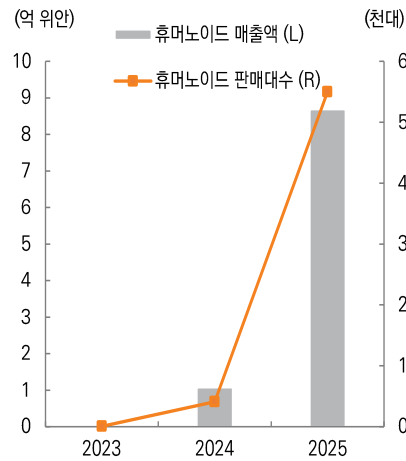


그림 15. 유비테크 휴머노이드 출하량/매출



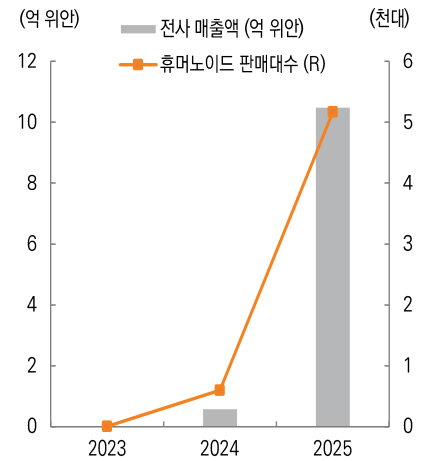
자료: UBTech, 미래에셋증권 리서치센터

그림 16. 유니트리 휴머노이드 출하량/매출



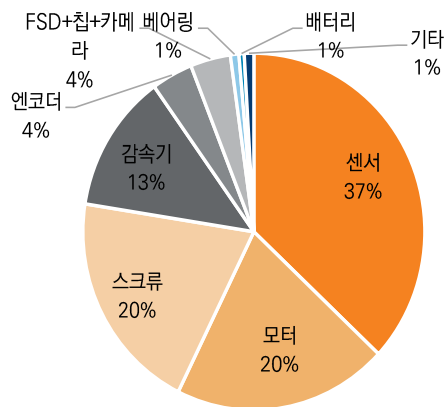
자료: Unitree, 미래에셋증권 리서치센터

그림 17. 애지봇 휴머노이드 출하량/매출



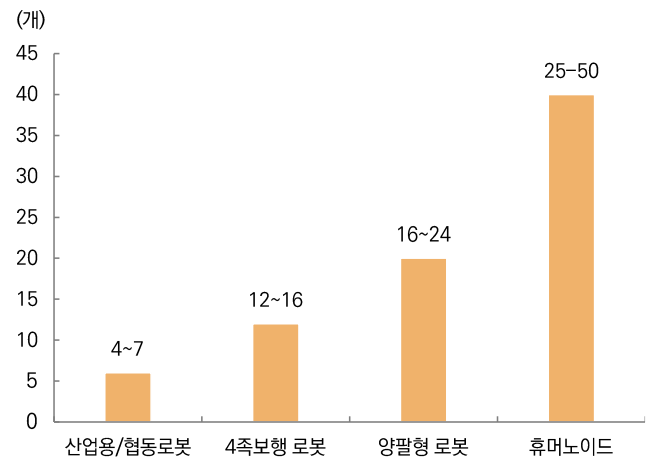
자료: AgiBot, 미래에셋증권 리서치센터

그림 18. 로봇 원가의 50% 이상을 차지하는 액추에이터



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 19. 로봇 종류별 요구되는 액추에이터 수



자료: 미래에셋증권 리서치센터

VI. One-Asia 테크 포트폴리오

글로벌 네트워크, 중국 반도체, 로봇틱스 산업의 신규 커버리지 개시로 아리스타 네트워크, 나우라 등 ‘매수’ 후보가 늘어났다. 하지만 여전히 한국 메모리 주식의 밸류에이션과 펀더멘털, 주주환원 측면에서 가장 선호된다. 이익 안정성을 확인해가며 장기간 멀티플 상승이 예상되고, 주주환원 여력이 소진된 글로벌 빅테크의 대안으로 떠오를 것이다.

중국 반도체는 메모리 뿐만 아니라, 팹리스, 파운드리, 장비 등 반도체 밸류체인 전체에 대한 익스포저가 필요하다. 자국 수요만으로도 충분히 매력적인 투자 자산이다. ETF를 통한 분산투자를 권하되, 좀 더 높은 리스크를 감내할 수 있는 투자자에게는 나우라를 추천한다.

빅테크 중에서는, 풀스택 AI로서 견고한 본업과 클라우드의 시장 점유율 상승을 이어갈 알파벳(GOOG US)을 추천한다. 아리스타 네트워크(ANET US)는 빅테크의 과도한 자본지출(Capex)을 우려하는 투자자에게 좋은 대안이다.

표 4. One-Asia Tech 포트폴리오

종목	티커	투자의견	목표주가	투자 포인트
삼성전자	005930 KS	매수	370,000원	이익 안정성에 기반한 주주환원 가능성 부각
SK하이닉스	000660 KS	매수	2,800,000원	27년 HBM 가격 상승 및 이익기여 예상
Global X China Semiconductor ETF	3191 HK			중국 반도체 밸류체인 핵심기업들에 대한 광범위한 익스포저
나우라	002371 CH	매수	1,100위안	선단공정 증설과 국산화가 만드는 장비 수요
알파벳	GOOGL US	매수	USD 500	풀스택 AI, 클라우드 점유율 상승
아리스타 네트워크	ANET US	매수	USD 330	데이터센터 증설(Q)과 800G, 1.6T 전환(P) 수혜

자료: 미래에셋증권 리서치센터

Appendix. One-Asia Tech Universe

표 5. One-Asia Tech Universe

그룹명	국가	회사명	시가총액 (조원)	12mf EPS revision (%)			Multiples (x)		Performance (%) (로컬 통화 기준)				
				1W chg.	1M chg.	3M chg.	12mf PER	12mf PBR	1W	1M	3M	6M	YTD
1 메모리/스토리지	한국	삼성전자	1508	1.0	0.4	18.2	4.0	1.7	0.8	-0.4	-18.9	19.0	115.0
1 메모리/스토리지	미국	마이크론	1481	0.0	-0.7	37.9	6.3	3.7	5.3	16.5	-1.2	132.6	236.1
1 메모리/스토리지	한국	SK하이닉스	1208	0.5	-1.0	13.4	3.9	2.0	-0.6	-3.8	-29.6	55.6	154.1
1 메모리/스토리지	중국	CXMT	802	3.8	8.8	-	15.5	8.3	2.5	7.5	-	-	-
1 메모리/스토리지	미국	Sandisk	314	0.3	7.7	13.8	7.1	5.9	4.9	29.0	-7.6	146.6	560.0
1 메모리/스토리지	미국	Seagate	257	0.0	7.0	37.0	21.2	18.9	4.2	-3.2	-5.8	103.6	201.5
1 메모리/스토리지	일본	Kioxia	235	3.6	4.2	22.0	4.2	3.0	-1.8	7.5	-24.1	135.7	379.1
1 메모리/스토리지	미국	Western Digital	212	0.0	4.3	13.8	20.6	11.3	3.5	-17.3	-15.2	61.2	161.7
1 메모리/스토리지	대만	Nanya	81	1.7	5.5	78.1	6.0	3.0	8.4	50.6	57.0	90.8	182.3
1 메모리/스토리지	중국	GigaDevice	58	0.0	32.4	165.4	20.0	6.2	6.4	7.2	-13.1	35.5	89.8
1 메모리/스토리지	대만	Winbond	35	0.0	34.9	64.7	4.1	2.1	3.1	40.4	15.5	49.8	122.1
2 프로세서/컴퓨트	미국	엔비디아	7278	12.8	14.1	16.7	17.2	12.0	5.9	10.0	4.7	24.8	18.5
2 프로세서/컴퓨트	미국	AMD	1051	-0.3	8.6	11.6	37.1	9.1	3.1	-1.1	-8.8	135.1	119.8
2 프로세서/컴퓨트	미국	인텔	647	4.2	4.9	36.3	47.5	3.8	2.6	-0.8	-21.9	96.3	142.6
2 프로세서/컴퓨트	대만	Mediatek	272	0.3	-0.8	12.5	34.0	11.9	4.2	10.4	-8.4	103.0	181.5
2 프로세서/컴퓨트	미국	Qualcomm	245	0.0	-1.5	-4.1	16.8	7.1	7.5	15.5	-31.8	21.0	0.7
2 프로세서/컴퓨트	중국	Cambricon Technologies	142	1.9	-3.8	19.1	68.3	28.8	14.8	0.6	-15.1	40.8	22.3
2 프로세서/컴퓨트	대만	Global Unichip	35	-3.2	-3.0	17.1	65.2	24.4	13.7	60.3	31.2	121.2	188.4
2 프로세서/컴퓨트	중국	Rockchip Electronics	17	-0.6	17.2	19.7	40.4	12.2	11.4	4.1	11.4	8.8	10.0
2 프로세서/컴퓨트	대만	Alchip Technologies	15	0.0	2.9	2.0	23.8	5.6	9.1	33.2	-7.7	16.8	16.1
3 네트워크/인터커넥트	미국	브로드컴	2410	-0.2	-0.2	-0.0	20.6	10.4	3.2	-4.9	-17.0	16.3	7.4
3 네트워크/인터커넥트	미국	Cisco	596	0.0	6.2	6.5	21.5	7.7	0.2	-4.7	-7.9	40.3	45.5
3 네트워크/인터커넥트	미국	Arista Networks	338	0.0	15.2	16.0	40.8	11.8	4.0	8.5	22.7	46.6	49.3
3 네트워크/인터커넥트	미국	암페놀	267	0.0	0.0	14.7	26.0	8.7	1.9	-1.3	6.7	8.9	17.7
3 네트워크/인터커넥트	미국	마벨 테크놀로지스	254	5.1	5.7	6.7	37.4	9.0	-7.7	12.8	3.3	159.3	149.4
3 네트워크/인터커넥트	중국	Innolight Technology	205	0.9	7.1	30.6	19.5	9.2	-2.1	-5.6	-26.6	59.7	39.8
3 네트워크/인터커넥트	미국	Corning	175	0.0	-0.3	3.5	37.5	8.8	2.4	7.8	-17.7	-0.8	70.8
3 네트워크/인터커넥트	미국	Lumentum	112	0.3	15.2	18.1	38.9	10.8	10.2	28.1	7.0	30.5	148.2
3 네트워크/인터커넥트	미국	Coherent	74	0.1	13.3	17.6	26.7	4.6	0.8	5.7	-23.1	7.3	50.5
3 네트워크/인터커넥트	미국	Astera Labs	70	0.0	34.2	42.1	53.8	19.0	7.0	-4.6	-13.4	149.9	78.5
3 네트워크/인터커넥트	일본	Sumitomo Electric	60	0.0	2.1	4.5	18.0	2.3	3.2	1.7	-29.4	-13.4	42.0
3 네트워크/인터커넥트	미국	Credo	58	0.2	2.4	5.6	31.2	11.6	1.6	9.3	-4.2	101.5	57.2
3 네트워크/인터커넥트	중국	Montage	51	-1.2	-1.0	0.4	51.6	11.9	6.8	0.0	-18.8	25.6	74.3
4 IP/EDA	미국	Arm	353	0.0	-0.5	1.2	93.7	21.8	1.3	0.9	-31.5	89.8	121.3
4 IP/EDA	미국	Cadence	128	0.0	0.1	2.0	37.4	12.2	7.2	-0.4	-9.6	12.4	8.4
4 IP/EDA	미국	Synopsys	115	2.6	2.4	2.7	25.5	2.3	11.4	13.1	-7.6	6.2	-6.4
5 파운드리	대만	TSMC	2946	0.0	0.3	12.3	20.4	7.2	1.3	2.7	-0.5	11.4	37.4
5 파운드리	중국	SMIC	141	0.0	26.6	29.7	42.5	2.9	6.0	11.9	-13.3	4.0	-1.0
5 파운드리	대만	UMC	70	0.0	-0.5	39.6	17.9	3.5	4.5	6.6	-9.2	100.6	166.4
5 파운드리	중국	Hua Hong Semiconductor	50	0.0	-1.5	6.3	102.6	3.8	13.1	-4.1	-23.7	27.1	65.5
5 파운드리	미국	Globalfoundries	34	0.0	3.6	3.8	18.8	1.9	-2.7	-10.6	-44.0	-5.9	28.2
6 장비	네덜란드	ASML	900	0.3	2.1	23.2	30.8	17.1	-2.5	4.1	5.3	17.3	59.3
6 장비	미국	Lam Research	516	0.0	0.1	20.5	30.5	17.8	-2.8	2.9	-5.2	29.1	76.5
6 장비	미국	Applied Materials	498	0.0	6.9	11.5	26.1	11.4	-5.3	-9.6	2.0	23.4	79.0

6	장비	미국	KLA	314	0.0	1.9	9.1	30.8	20.9	-3.4	-3.9	-8.6	15.4	44.9
6	장비	일본	Tokyo Electron	226	0.2	1.9	11.5	28.1	9.5	2.3	1.7	7.7	29.4	66.0
6	장비	일본	Advantest	211	0.0	9.0	31.8	32.2	15.8	-2.3	3.7	28.7	25.6	71.8
6	장비	중국	NAURA Technology	103	-0.4	0.3	-3.6	50.9	9.8	-1.1	1.9	11.2	48.4	52.6
6	장비	미국	Teradyne	75	0.0	0.0	18.4	33.1	12.7	-4.1	-4.9	-6.5	9.4	80.9
6	장비	중국	AMEC	71	0.0	5.5	18.9	68.5	10.0	1.2	5.2	21.6	53.1	97.9
6	장비	일본	Disco	54	0.0	1.1	6.7	29.9	8.0	-5.4	-0.6	-10.7	-22.6	21.3
6	장비	일본	Lasertec	27	0.6	1.2	7.3	27.4	8.8	-3.4	-11.3	-15.8	0.3	13.9
6	장비	네덜란드	BESI	25	0.0	1.1	10.1	33.5	19.3	-6.0	-1.4	-31.3	3.9	47.1
6	장비	한국	한미반도체	21	0.0	0.0	-5.8	48.0	18.4	5.5	4.3	-23.9	-30.3	72.8
7	소재	일본	Shin Etsu	102	0.1	0.1	-2.7	18.9	2.4	-0.5	3.8	-22.4	-1.5	24.7
7	소재	일본	Hoya	71	-0.8	1.1	2.9	28.9	7.8	-1.2	-0.3	-9.2	-12.4	4.5
7	소재	미국	Entegris	28	0.0	7.7	8.8	28.9	4.3	-2.1	13.6	-2.4	2.3	61.0
7	소재	일본	Resonac	26	1.5	7.7	5.9	21.6	3.4	0.4	15.4	-15.4	32.8	142.8
7	소재	일본	NGK Insulators	13	0.9	2.6	8.8	16.4	1.7	-1.5	-4.8	-15.7	17.2	60.5
7	소재	일본	SUMCO	10	4.6	38.4	44.4	76.9	1.9	-1.4	1.3	-14.6	86.5	137.6
7	소재	일본	Tokyo Ohka Kogyo	9	0.3	1.6	5.9	21.6	3.7	-0.3	-3.1	-21.5	-6.3	48.8
8	후공정/패키지기판	대만	ASE	113	0.0	0.6	18.6	23.3	5.7	-1.4	5.2	-3.5	52.1	135.3
8	후공정/패키지기판	대만	Unimicron	71	0.0	-0.6	32.6	29.8	9.9	-7.1	26.9	-5.1	107.9	355.0
8	후공정/패키지기판	일본	Ibiden	50	-0.7	7.0	20.6	59.5	8.4	8.8	22.9	-11.1	114.9	204.4
8	후공정/패키지기판	일본	Kyocera	44	0.6	4.3	18.1	29.9	1.4	2.3	-0.9	5.0	33.8	68.4
8	후공정/패키지기판	대만	Nanya PCB	34	0.4	10.0	50.8	35.0	11.8	8.4	33.7	45.4	122.1	411.4
8	후공정/패키지기판	대만	Zhen Ding	24	0.0	2.1	17.0	22.7	3.5	14.8	20.9	-2.2	140.9	254.5
8	후공정/패키지기판	대만	Kinsus	19	0.0	0.6	27.7	39.4	8.1	3.1	29.0	12.5	160.9	433.7
8	후공정/패키지기판	미국	Amkor	16	-0.2	0.2	16.9	17.5	2.0	-1.3	-5.2	-31.9	-0.8	20.2
8	후공정/패키지기판	한국	LG이노텍	15	-0.2	1.3	13.9	14.0	1.9	12.9	26.8	-56.6	99.3	137.2
8	후공정/패키지기판	대만	KYEC	14	0.2	-1.7	-0.8	20.4	4.7	7.5	15.0	-17.6	-17.2	9.4
8	후공정/패키지기판	대만	Powertech	9	0.0	0.0	0.5	17.5	2.9	2.8	17.6	-25.5	9.5	63.3
8	후공정/패키지기판	한국	이수페타시스	8	0.0	7.5	7.5	21.5	6.3	13.4	55.1	-12.5	-9.9	-4.6
9	서버시스템/부품	미국	Dell	403	1.7	3.5	9.1	21.3	80.4	5.3	12.5	8.5	209.4	265.6
9	서버시스템/부품	대만	폭스콘	151	-0.1	4.7	6.6	11.6	1.7	2.7	-0.2	-10.9	5.9	11.7
9	서버시스템/부품	일본	Murata	121	0.1	0.4	14.9	32.3	4.3	1.8	-3.0	-25.3	76.7	123.6
9	서버시스템/부품	한국	삼성전기	108	1.0	0.8	38.1	41.1	8.4	10.3	26.2	-32.8	217.8	464.0
9	서버시스템/부품	미국	HPE	95	0.1	1.4	1.3	13.0	2.4	-0.4	9.1	21.7	145.6	119.5
9	서버시스템/부품	대만	Quanta	60	0.0	11.1	11.8	11.2	4.2	4.2	16.1	4.1	21.1	29.8
9	서버시스템/부품	대만	Wiiwynn	57	0.0	4.9	13.2	14.9	6.6	12.6	31.6	34.1	82.5	62.8
9	서버시스템/부품	대만	Yageo	48	0.0	-0.8	19.9	19.7	3.5	-1.1	8.6	-25.6	84.2	137.6
9	서버시스템/부품	대만	위스트론	24	0.0	6.7	30.3	8.3	2.1	1.4	1.1	16.4	35.7	22.6
10	DC/인프라	미국	GE 베르노바	327	0.0	2.1	6.0	37.0	13.6	-4.6	-9.3	-7.2	3.0	37.7
10	DC/인프라	미국	넥스트에라 에너지	235	0.0	-0.1	0.3	19.2	2.3	-1.4	-4.6	-4.0	-10.9	4.8
10	DC/인프라	미국	Equinix	141	0.0	0.7	2.1	55.7	7.1	-0.8	3.2	-1.5	8.5	38.7
10	DC/인프라	미국	버티브	136	0.0	0.3	4.4	31.3	12.9	1.5	7.1	-18.0	1.5	59.8
10	DC/인프라	미국	Digital Realty	96	-2.2	7.9	58.5	57.7	2.7	-1.6	-1.6	-1.7	6.2	21.6
10	DC/인프라	미국	블룸 에너지	83	2.3	4.8	13.6	50.5	20.9	1.1	0.2	-27.6	32.5	137.4
10	DC/인프라	미국	비스트라	63	-0.2	-6.2	-4.7	14.0	7.1	1.3	-7.3	-14.1	-20.8	-14.6
11	클라우드/SW	미국	알파벳	5645	0.3	-1.0	15.5	19.6	5.0	-2.5	-4.7	-10.7	9.0	8.6
11	클라우드/SW	미국	마이크로소프트	5152	0.0	-0.1	2.1	24.8	6.4	4.1	9.4	12.9	29.7	5.6
11	클라우드/SW	미국	아마존 닷컴	3833	0.0	0.0	16.8	19.8	4.2	-0.9	-4.3	-4.0	23.7	12.5
11	클라우드/SW	미국	메타 플랫폼스	1994	-0.8	-1.8	-8.0	15.5	4.0	2.4	2.8	-9.4	-11.5	-13.1
11	클라우드/SW	미국	팔란티어	612	-0.1	7.4	12.3	89.1	27.5	6.0	51.5	19.1	35.9	4.9
11	클라우드/SW	미국	오라클	588	-0.1	-0.1	0.0	17.1	5.0	4.7	14.8	-33.7	3.3	-22.8
11	클라우드/SW	중국	알리바바	396	-0.3	-2.4	-3.0	15.2	1.5	1.5	-2.4	-4.7	-19.4	-19.3

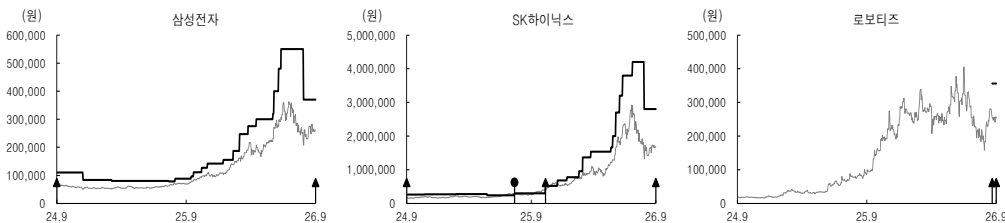
11	클라우드/SW	미국	클라우드플레어	149	0.1	5.9	10.4	194.8	43.8	8.8	9.4	26.2	77.2	54.8
11	클라우드/SW	미국	코어위브	65	0.0	-18.6	-55.1	-	10.8	-1.6	18.3	-22.5	6.7	18.5
12	디바이스/세트	미국	애플	6325	-0.1	-0.1	-1.2	33.4	33.2	2.1	2.7	1.6	20.2	16.9
12	디바이스/세트	중국	샤오미	124	0.8	-8.6	-15.0	19.3	2.0	-0.7	-4.0	-1.5	-20.9	-29.7
12	디바이스/세트	중국	Lenovo	65	0.0	45.1	67.2	12.0	4.1	1.3	27.6	26.9	212.9	228.8
12	디바이스/세트	미국	HP	37	5.8	5.4	5.6	9.4	32.3	5.0	10.1	12.4	62.6	38.6
13	로보틱스	미국	테슬라	1988	-2.8	-3.8	-9.8	181.7	13.5	5.4	18.2	-15.6	-8.6	-18.2
13	로보틱스	한국	현대차	82	-0.6	-1.1	-4.5	8.8	0.8	-1.8	5.8	-44.7	-39.5	37.5
13	로보틱스	일본	화낙	51	0.4	1.5	4.9	26.5	2.9	0.0	-15.1	-23.3	-14.0	0.5
13	로보틱스	중국	저장 쉐화 지능 공제	30	-1.9	-2.1	-3.6	30.5	4.1	1.7	-3.3	-21.1	-28.6	-33.8
13	로보틱스	중국	리더하모닉	11	-1.0	-1.4	8.5	215.2	14.4	1.8	-1.0	-1.8	29.4	56.5
13	로보틱스	중국	유비테크 로보틱스	8	153.1	241.7	236.0	1603.3	4.9	6.5	4.0	-17.0	-30.2	-32.9
13	로보틱스	한국	로보티즈	4	-1.8	-8.7	-15.8	227.4	10.5	2.0	40.0	-21.4	-11.7	-1.9
13	로보틱스	한국	에스피지	2	0.0	0.0	0.0	133.2	7.2	-0.3	0.4	-20.8	-35.7	15.7

자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터 | 기준일자: 26.08.31

투자 의견 및 목표주가 변동 추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	과리율(%)		제시일자	투자의견	목표주가(원)	과리율(%)	
			평균주가대비	최고(최저)주가대비				평균주가대비	최고(최저)주가대비
삼성전자 (005930)					2026.06.25	매수	4,200,000	-49.93	-36.36
2026.07.29	매수	370,000	-	-	2026.05.27	매수	3,800,000	-37.91	-23.18
2026.05.27	매수	550,000	-44.49	-34.09	2026.05.18	매수	3,200,000	-41.11	-35.88
2026.05.20	매수	480,000	-38.13	-37.60	2026.05.07	매수	2,700,000	-31.07	-26.81
2026.05.07	매수	400,000	-30.00	-26.00	2026.04.28	매수	2,000,000	-29.66	-19.95
2026.05.04	매수	320,000	-16.88	-16.88	2026.04.23	매수	1,660,000	-24.28	-22.17
2026.03.18	매수	300,000	-32.55	-24.67	2026.02.23	매수	1,540,000	-35.84	-20.52
2026.02.23	매수	275,000	-29.93	-20.73	2026.01.30	매수	1,370,000	-35.82	-30.73
2026.01.30	매수	247,000	-31.01	-23.04	2026.01.19	매수	956,000	-18.37	-9.94
2026.01.12	매수	187,000	-19.63	-13.16	2025.12.15	매수	782,000	-15.38	-3.32
2025.12.15	매수	155,000	-21.84	-9.03	2025.11.17	매수	680,000	-19.03	-13.68
2025.10.31	매수	142,000	-27.74	-21.76	2025.10.29	매수	520,000	13.77	19.23
2025.10.15	매수	127,000	-21.89	-18.03	2025.10.29	매수	520,000	0.19	0.19
2025.09.22	매수	111,000	-21.22	-14.95	2025.10.13	매수	520,000	-8.35	2.88
2025.09.15	매수	96,000	-17.24	-16.15	2025.07.14	중립	300,000	-2.47	42.67
2025.08.01	매수	88,000	-19.69	-14.32	2025.04.25	매수	244,000	-4.68	21.72
2025.07.14	매수	78,000	-13.28	-6.92	2025.01.24	매수	277,000	-29.61	-21.12
2025.02.03	매수	80,000	-28.59	-20.25	2024.10.24	매수	270,000	-31.75	-16.48
2024.11.14	매수	84,000	-35.00	-30.60	2024.07.25	매수	260,000	-31.80	-23.19
2024.05.16	매수	110,000	-34.12	-20.18	로보티즈 (108490)				
SK하이닉스 (000660)					2026.08.21	매수	356,000	-	-
2026.07.29	매수	2,800,000	-	-					

* 과리율 산정: 수정주가 적용, 목표주가 대상시점은 1년이며 목표주가를 변경하는 경우 해당 조사분석자료의 공표일 전일까지 기간을 대상으로 함



투자 의견 분류 및 적용 기준

기업	산업
매수 : 향후 12개월 기준 절대수익률 20% 이상의 초과수익 예상	비중확대 : 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 높거나 상승
중립 : 향후 12개월 기준 절대수익률 -10~10% 이내의 등락이 예상	중립 : 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 수준
매도 : 향후 12개월 기준 절대수익률 -10% 이상의 추가하락이 예상	비중축소 : 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 낮거나 악화

매수(▲), Trading Buy(■), 중립(●), 매도(◆), 추가(→), 목표주가(→), Not covered(■)

* 2025년 5월 12일 기준으로 투자 의견 분류 기준 변경(Trading Buy 의견 삭제)

* 향후 12개월 기준 절대수익률 10% 이상, 20% 미만의 추가상승이 예상되는 종목은 금융투자분석사 재량에 따라 '매수' 또는 '중립' 의견으로 제시함

투자 의견 비율

매수(매수)	Trading Buy(매수)	중립(중립)	매도
83.02%	0%	16.35%	0.63%

* 2026년 06월 30일 기준으로 최근 1년간 금융투자상품에 대하여 공표한 최근일 투자등급의 비율

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 SK하이닉스, 삼성전자 을(률) 기초자산으로 하는 주식워런트증권에 대해 유동성공급자(LP)업무를 수행하고 있습니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트 박선영은(는) 자료작성일 현재 SK하이닉스 210주 보유하고 있습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트 박선영은(는) 자료작성일 현재 삼성전자 400주 보유하고 있습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트 권영배, CFA의 배우자는 자료작성일 현재 삼성전자 300주 보유하고 있습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트 권영배, CFA의 배우자는 자료작성일 현재 삼성전자우 4416주 보유하고 있습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.